

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年1月26日(2012.1.26)

【公開番号】特開2010-141202(P2010-141202A)

【公開日】平成22年6月24日(2010.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2010-025

【出願番号】特願2008-317228(P2008-317228)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

H 01 L 21/324 (2006.01)

H 01 L 21/22 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 N

H 01 L 21/31 E

H 01 L 21/324 Q

H 01 L 21/22 5 1 1 G

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月6日(2011.12.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】基板処理装置及び半導体装置の製造方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を処理する反応炉と、該反応炉内で基板を保持する基板保持具と、該基板保持具内に設けられ、前記基板と接触するリング状の支持板と、該支持板と異なる材質で形成された前記支持板を載置する補助支持板とを具備し、前記支持板の裏面に凹部を形成し、前記補助支持板には前記凹部に嵌合する凸部を設けたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

基板を処理する反応炉と、該反応炉内で基板を保持する基板保持具と、該基板保持具内に設けられ、前記基板と接触するリング状の支持板と、該支持板と異なる材質で形成された前記支持板を載置する補助支持板とを具備し、該補助支持板にリング状の凸部を設け、該突条は前記支持板の側面と嵌合可能であることを特徴とする基板処理装置。

【請求項3】

前記支持板の基板接触部の幅は、前記補助支持板との接触部の幅よりも狭い
請求項1または請求項2記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記支持板は、前記基板を支持する凸部を持つ凸形状である請求項1または請求項2記載の基板。

【請求項5】

前記凸部は、前記支持板と同一円周上に所定の間隔で断続的に設けられ、前記凹部は前記凸部を収容可能に設けられた請求項1記載の基板処理装置。

【請求項6】

前記補助支持板の中心部に、前記支持板の内径と同じか、該支持板の内径よりも小さい孔を穿設したことを特徴とする請求項1または請求項2記載の基板処理装置。

【請求項7】

基板と接触する支持板と、該支持板を支持する補助支持板とを具備し、前記支持板の裏面には凹部が形成され、前記補助支持板には前記凹部に嵌合する凸部が設けられた基板保持具により基板を支持する工程と、前記基板保持具により支持する前記基板を反応炉に装入する工程と、該反応炉内で前記基板保持具により支持する前記基板を熱処理する工程と、前記基板保持具により支持する熱処理後の前記基板を前記反応炉より装脱する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。